NEWS RELEASE

名古屋市東区東桜一丁目１番１号
アーバンネット名古屋ネクスタビル

2026 年 1 月 8 日

各 位

日本特殊陶業株式会社

【日本特殊陶業株式会社、NTK セラミック株式会社共同出展】
「第 40 回ネプコンジャパン」出展のお知らせ
(2026 年 1 月 21 日(水)～1 月 23 日(金))

Niterra グループ 日本特殊陶業株式会社（社長：川合 尊、本社：名古屋市東区）、及び NTK セラミック株式会社（社長：福寄 洋光、本社：愛知県小牧市）は、2026 年 1 月 21 日（水）から 1 月 23 日（金）までの 3 日間、東京ビッグサイトで開催される「第 40 回ネプコンジャパン」に共同で出展しますので、下記の通りお知らせします。

●出展の見どころ

ネプコンジャパンは、アジア最大級のエレクトロニクス開発・実装展として、エレクトロニクス機器の多機能化・高性能化を支える世界最先端の電子部品・材料や製造・実装・検査装置メーカーが出展する総合展です。

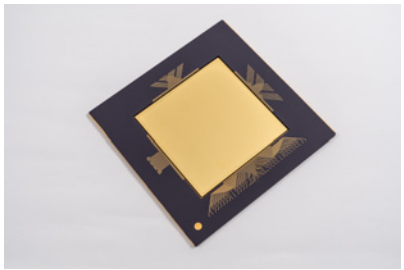
当社グループでは 1967 年にセラミック IC パッケージの製造を開始し、多種多様な構造の製品や市場に求められる材料を量産化することで、世の中の便利さや快適さを支えてきました。

高強度、高熱伝導率、低熱膨張という材料の特徴を活かしたセラミックパッケージ・基板に加え、開発中のセラミック材料、セラミック製品技術をご紹介します。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

●主な展示製品・技術

[大型セラミックパッケージ]



・大型 CMOS イメージセンサー向けセラミックパッケージ。

外形サイズ：□130mm
厚み：2.1mmt (7 層品)
ダイアタッチサイズ：□82mm
CuW ヒートシンク採用

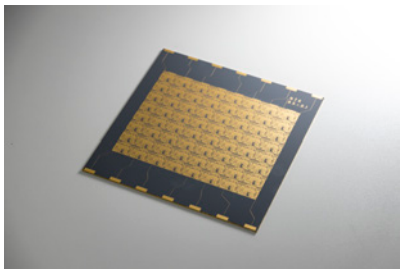
[窒化アルミニウム基板]



・φ300mm 窒化アルミニウム基板

外形サイズ：φ300mm
厚み：1.0mmt
平坦度：80μm
熱伝導率：>170W/(m· K)

[半導体検査用セラミック基板]



・半導体検査用プローブカード基板

外形サイズ：□172mm
厚み：1.6mmt
電気抵抗率：7μΩ· cm

名古屋市東区東桜一丁目１番１号
アーバンネット名古屋ネクスタビル

●展示会　概要

名称	第 40 回 ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展-
主催	RX Japan 株式会社
会期	2026 年 1 月 21 日[水]～23 日[金]　10:00～17:00
会場	東京ビッグサイト（東ホール）https://www.bigsight.jp/visitor/access/ ※当社小間番号：E25-19
入場料	無料（公式サイトから事前申込みによる来場登録が必要）
リンク	https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp.html#/

※NTK セラミックの Web サイトでのご紹介もご覧ください。
https://www.ntktechnicalceramics.com/topics/index.html#topics01

以上